

5-535541-8 ✓ 有效

AMPMODU | Modu Connector System

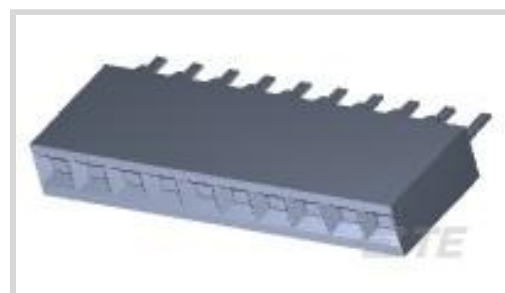
TE 内部编号 5-535541-8

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 10 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Signal, Modu Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 10

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| 施加的压力 | 标准 |
| 连接器系统 | 板对板 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装母端 |

结构特性

| | |
|----------|----|
| 板对板配置 | 平行 |
| 可堆叠 | 是 |
| 位数 | 10 |
| 行数 | 1 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

电气特征

| | |
|------------|---------|
| 介质耐压 (最大值) | 750 VAC |
| 绝缘电阻 | 5000 MΩ |
| 工作电压 | 333 VAC |

主体特性

| | |
|--------|----|
| 连接器外形 | 标准 |
| 主要产品颜色 | 黑色 |

接触件特性

| | |
|------------------|---------------------------|
| 端子保护类型 | 闭合入口壳体 |
| 接合方柱尺寸 | .64 mm[.025 in] |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 3.81 – 50 μ m |
| 端子布局 | 直插式 |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .762 μ m[30 μ in] |
| 端子形状和构造 | 正方形 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子基材 | 磷青铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子类型 | 插座 |
| 端子额定电流（最大值） | 3 A |

端接特性

| | |
|-------------|------------------|
| 矩形端接柱体和尾部厚度 | .2 mm[.008 in] |
| 矩形端接柱体和尾部宽度 | .7 mm[.028 in] |
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.18 mm[.125 in] |
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |

机械附件

| | |
|----------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
| 接合对准 | 不带 |
| PCB 安装对准 | 不带 |
| PCB 安装固定 | 不带 |

壳体特性

| | |
|---------|----------------|
| 接合入口位置 | 顶部 |
| 外壳材料 | 聚酯 - GF |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

| | |
|------------|------------------------------|
| 堆叠高度 | 9.02 mm[.355 in] |
| 连接器高度 | 3.56 mm[.14 in] |
| PCB 厚度（建议） | 1.4 – 2.4 mm[.055 – .094 in] |

使用环境

| | |
|---------|----|
| 壳体温度额定值 | 标准 |
|---------|----|

工作温度范围 -65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

操作/应用

| | |
|--------|--------|
| 焊接工艺特性 | 板支座 |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

| | |
|-------------|-----------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

包装特性

| | |
|------|-----------|
| 封装数量 | 22 |
| 封装方法 | Box, Tube |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月 (223) 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 265°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

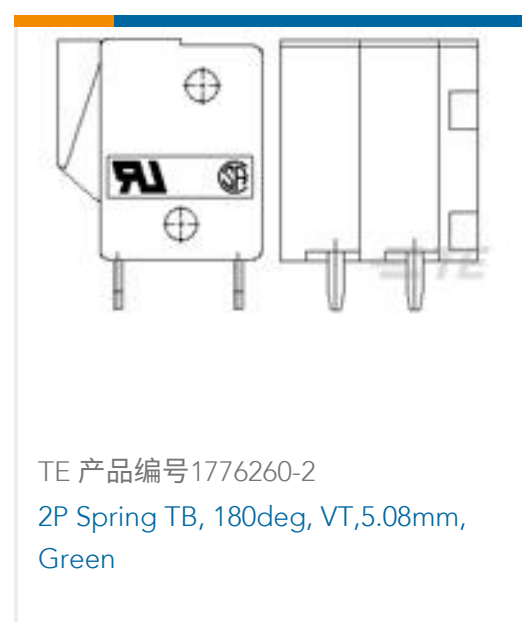
配套部件



该系列中的其他产品 | Modu Connector System



客户还购买了





文档

产品图纸

[10 MODIV VRT SR CE 100/115](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_5-535541-8_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_5-535541-8_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_5-535541-8_N.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本